

Requested Patent: JP1028856

Title: MULTILAYERED INTEGRATED CIRCUIT

Abstracted Patent: JP1028856

Publication Date: 1989-01-31

Inventor(s): TAKEUCHI RYOSUKE

Applicant(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Application Number: JP19870182307 19870723

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L27/00 ; H01L23/52 ; H01L25/08

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a large scale integrated circuit with high reliability, by stacking, on an LSI chip of lower side layer, an LSI chip whose area is smaller than that of the LSI chip of lower side layer, and connecting, through wires, the LSI chip of the upper side layer and that of the lower side layer.

CONSTITUTION: A multilayer integrated circuit is formed, by stacking at least two or more layers of large scale integrated circuit chips 10-12. The area of the chip 11 of upper layer stacked on the chip 10 of lower layer is larger than the area of the chip 12 of upper layer stacked on the chip 11 of lower layer. The signal transmission and reception between the chip 10 and the chip 11 and between the chip 11 and the chip 12 is performed via a wire 15a. Thereby, a large scale integrated circuit with high reliability can be obtained.

◎公開特許公報(A) 昭64-28856

◎Int.Cl.

H 01 L 27/00
23/52
25/08

識別記号

301

庁内整理番号

A-8122-5F
B-8728-5F
B-7638-5F

◎公開 昭和64年(1989)1月31日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 多層集積回路

◎特願 昭62-182307

◎出願 昭62(1987)7月23日

◎発明者 武内 良祐 兵庫県尼崎市塙日本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社
通信機製作所内

◎出願人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

◎代理人 弁理士 田澤 博昭 外2名

明細書

1. 発明の名称

多層集積回路

2. 特許請求の範囲

大規模集積回路チップを少なくとも2層以上積層してなる多層集積回路において、下側層の上記大規模集積回路チップ上に積層される上側層の上記大規模集積回路チップの面積を大きくし、かつ上側層と下側層との大規模集積回路チップのバッド間には信号の授受するためにワイヤを接続したことを特徴とする多層集積回路。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は電子機器等に組込まれる多層集積回路に関するものである。

(従来の技術)

第3図は例えば1985年10月7日発行の「已経エレクトロニクス」のP235に掲載された従来の多層集積回路を示す一節切欠斜視図であり、図において、1は下層大規模集積回路チップ(以

下下層LSIチップという)、2は上層大規模集積回路チップ(以下上層LSIチップといふ)、3はこれら下層LSIチップ1および上層LSIチップ2に設けられたハンティングパッド(以下パッドといふ)、4は線配線で、上記下層LSIチップ1のパッド3と上層LSIチップ2のパッド3とを電気的に接続する。5はハンダで、接觸された下層LSIチップ1と上層LSIチップ2とをパッド3を介して接続する。

次に動作について説明する。

上層LSIチップ2と下層LSIチップ1との信号の送受信は線配線4を介在させて行う。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の多層集積回路は以上のように構成されているので、上層LSIチップ2と下層LSIチップ1を接続するには上層LSIチップ2に線配線4を形成させ、上層LSIチップ2の線配線の位置に対しても下層LSIチップ1のパッド3の位置がずれてはならず、そのため製造コストが高くなり、またそれがあった場合に修正ができないので、

接続4とパッド3との結縁部分の信頼性が低く、入出力信号は最上層のLSIチップのパッド3からしか取り出せないという制約があるなどの問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、複層されるLSIチップ間の接続の信頼性を高め、かつ製造コストを低減できる多層集積回路を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る多層集積回路は下側層のLSIチップより小さな面積のLSIチップをその上に積層し、上側層と下側層とのLSIチップのパッドをワイヤで結縁したものである。

[作用]

この発明にかかる多層集積回路は上側層、下側層のパッドをワイヤボンディングすることで結縁を行い、容易に信頼性の高い大規模集積回路を得ることができ、また入出力信号線をいずれの層のLSIチップからでも取り出せるものである。

[実施例]

11との信号の授受あるいは第2層LSIチップ11と第3層LSIチップ12との信号の授受はワイヤ15aにより行われる。また、第2層LSIチップ11や第3層LSIチップ12の基板の基準電位は第2層LSIチップ11の下の導体膜17を電源あるいはアースなどの基準電位に接続することで得ることができる。

また、上記実施例では導体膜にワイヤボンディングで基準電位を与える方法を用いたが、導体膜に基準電位を与える方法としては絶縁膜の一端に穴を開け、下側層のLSIチップの部分にパッドを設け、ハンダ等で上側層のチップの導体膜と接続してもよい。

また、上記実施例では3層の多層集積回路を示したが、2層以上であれば何層でもよく、上記実施例と同様の効果を奏する。

[発明の効果]

以上のようにこの発明によれば、各層のパッドをワイヤで結縁が可能なようになり多層集積回路を構成したので安価に高集成化でき、信頼性も高いも

以下、この発明の一実施例を図1について説明する。

第1図はこの発明の一実施例の概略構成を示す平面図、第2図は同じく側面図で、両図とも3層のLSIチップを重ねた多層集積回路を示す。両図において、10は第1層LSIチップ10上に積層される第2層LSIチップ、11は第2層LSIチップ11上に積層される第3層LSIチップ、13aは第1乃至第3層LSIチップ10,11,12上のパッド、13bはLSIパッケージ14のパッド、15aは第1層LSIチップ10のパッド13aと第2層LSIチップ11のパッド3を接続したワイヤ、15bは第2層LSIチップ11のパッド3とLSIパッケージ14のパッド13bとを接続したワイヤ、16は各層を絶縁する絶縁膜で17はそれぞれ上側層のLSIチップに基準電位を与えるための導体膜である。

次に動作について説明する。

第1層LSIチップ10と第2層LSIチップ

のが得られる効果がある。

4. 側面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による多層集積回路の概略構成を示す平面図、第2図は同じく側面図、第3図は従来の多層集積回路の一例を示す一例を示す。

10,11,12はLSIチップ、13a,13bはパッド、15a,15bはワイヤ。

なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。

特許出願人 三菱電機株式会社

代理人弁理士 田 門 博 昭

(外2名)

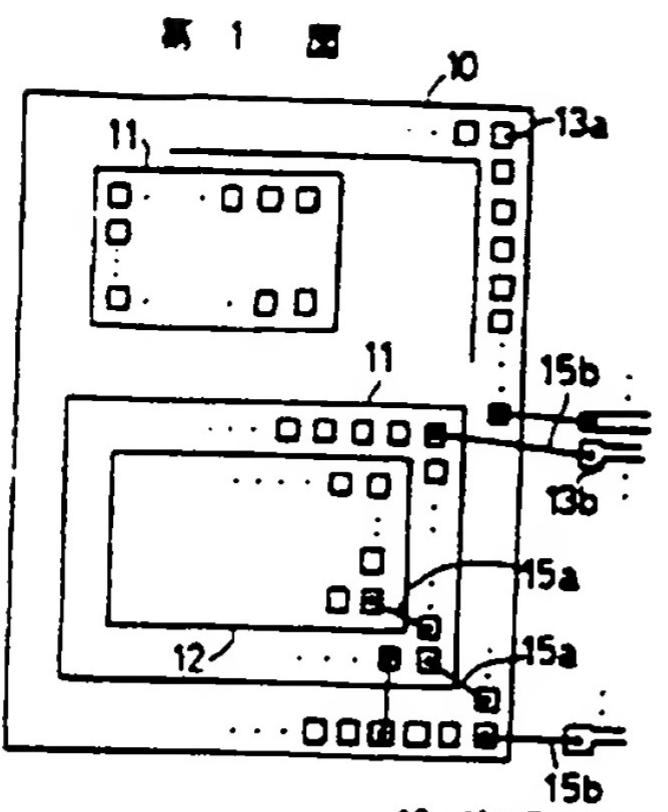
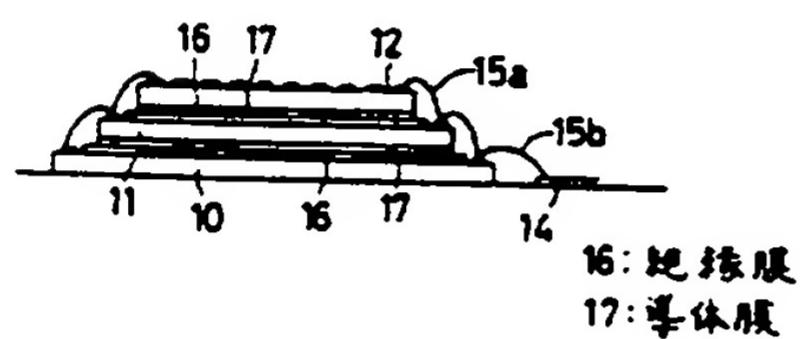
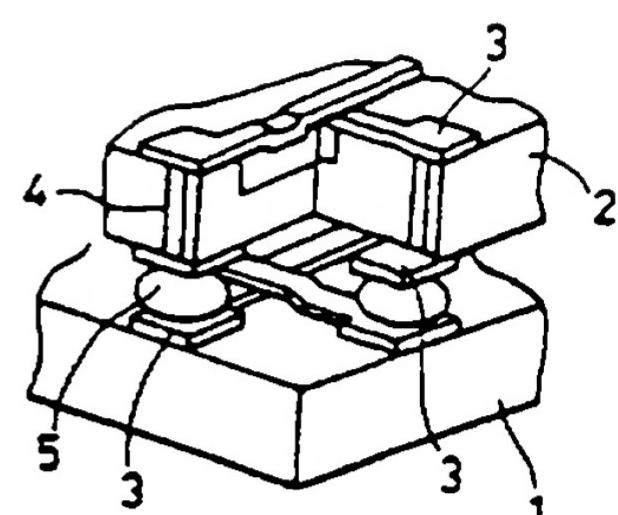


図 2

10: 第1号LSIチップ
 11: 第2号LSIチップ
 12: 第3号LSIチップ
 13a:LSIペント
 13b: パッケージペント
 15a,15b: ワイヤ

図 3



16: 絶縁膜
 17: 半導体膜